



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Redundante Prozessormodule
Imprägnierungsmaterial	Schutzbeschichtet

Zusatzmerkmale

Anzahl von Racks	1
Anwendungspezifischer E/A	Zähler Motion Control SSI-Encoder Genaue Zeitstempelung Serielle Schnittstelle HART
Prüfungen	Prozesssteuerung Sicherheitssteuerung (Safety)
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B 1 Ethernet für HSBY-Port
Anzahl entfernter E/A-Stationen	8 - 2 Einbaugehäuse pro Remote-Station (RIO drop)
Anzahl verteilter Geräte	61
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	4,0 Ethernet-Kommunikationsmodul 16,0 AS-Interface-Modul
Kommunikationsdienst	DIO-Scanner RIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 8 MB für Programmprozess Integriert RAM, 768 kB für Datenprozess Integriert RAM, 2 MB für Programmsicherheit Integriert RAM, 512 kB für Datensicherheit
Anwendungsstruktur	1 Master Task 1 periodische Fast Task 1 periodische sichere Task
Cybersicherheit	Achilles-zertifiziert DoS-Abwehr IPSec SNMP-Logging Syslog-Protokollunterstützung Autit Trail (logging) Integrierte Firewall Firmware-Signatur Passwortschutz Härtung Sicherheitsprotokoll

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobeschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Anzahl der Anweisungen pro ms	10 Kinst/ms 100 % boolesch 7,5 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch
Stromaufnahme	360 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	638000 H
Beschriftung	CE

Montage

Vibrationsfestigkeit	3 gn
Stoßfestigkeit	15 gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Handelsmarine[RETURN] Zone 2/22[RETURN]IECEx Zone 2/22[RETURN]TÜV
Normen	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2 EN/IEC 61850-3, Standort G IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-3-2 EN 50121-4 EN 50121-5 EN 45545-2 IEC 60571 IEC 62236-3-2 IEC 62234-4 IEC 62234-5
Umgebungseigenschaften	Gefahrenbereich Klasse I Division 2 Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04 Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3 Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Pilzsporen-resistant Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Beschichtung	Schutzlack
Sicherheitsniveau	SIL 3 entspricht IEC 61508 SIL 3 entspricht IEC 61511 SILCL 3 entspricht IEC 62061 SILCL 3 entspricht ISO 13849-1 Kategorie 4 SIL 4 entspricht EN 50126 SIL 4 entspricht EN 50128 SIL 4 entspricht EN 50129
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus) 1 LED (grün) Peer-Prozessor in Betrieb (REMOTE RUN) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis A (A) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis B (B) 1 LED (grün) Prozessor primär (PRIM) 1 LED (grün) Prozessor Standby (STBY) 1 LED (rot) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO) 1 LED (grün) Prozessor im Sicherheitsmodus (SRUN) 1 LED (grün) Prozessor im Wartungsmodus (SMOD) 1 LED (grün) Hot-Standby-Verbindungsstatus (HSBY Diag)
Produktgewicht	0,849 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	25,000 cm
VPE 1 Gewicht	893,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,854 kg

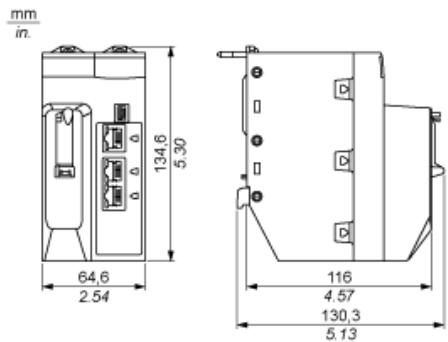
Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

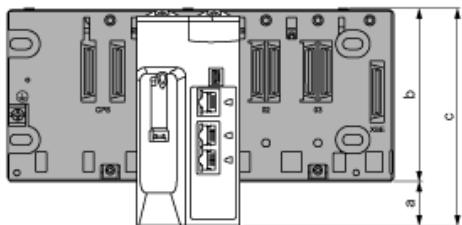
Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nur CPU-Module

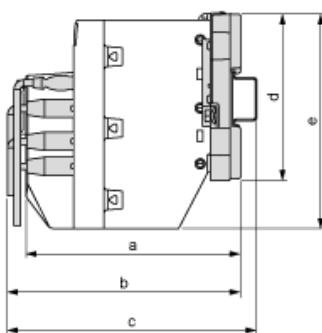


Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.) Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)